

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

Mécanisme de Promotion de la fabrication de composants électroniques et semiconducteurs (SPECS)

1. Contexte

Le gouvernement accorde une grande importance à la fabrication de matériel électronique comme l'un des piliers des initiatives « Make in India » et « Digital India » du gouvernement indien. L'industrie de la fabrication électronique indienne fait face à un retard actuel de l'ordre de 8 à 10 % par rapport aux économies compétitrices sur différents segments de la fabrication électronique, et différentes étapes de la chaîne de valeur.

1.2 L'industrie domestique de fabrication électronique a connu une croissance considérable au cours des dernières années, en passant des stades de fabrication Semi Knocked Down (SKD, assemblage partiel) à Completely Knocked Down (CKD, assemblage complet). Toutefois, la création de valeur domestique reste faible, comprise entre 10 et 30 % seulement. Cela est dû à l'absence d'écosystème de fabrication de composants électroniques, à la quasi-absence d'écosystème de fabrication de semiconducteurs et à l'absence d'écosystème de fabrication d'écrans dans le pays. Une grande partie de la croissance de la fabrication électronique dans le pays s'est produite sur l'assemblage de produits finis à partir de composants électroniques, sous-assemblages et pièces importés, principalement pour répondre à la demande intérieure.

1.3 Le développement de la chaîne d'approvisionnement est essentiel pour la fabrication de produits électroniques générant une valeur ajoutée domestique plus importante. L'objectif de la Politique nationale pour l'électronique de 2019 (NPE 2019), dévoilée le 25 février 2019, est de positionner l'Inde comme hub mondial pour la Conception et la fabrication de systèmes électroniques (ESDM) en encourageant et en catalysant les capacités du pays pour le développement de pièces

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

maîtresses, notamment de puces, et la création d'un environnement permettant à l'industrie d'être compétitive sur le marché mondial.

1.4 La fabrication de composants électroniques et de semiconducteurs demande des capitaux importants et doit faire face à l'évolution constante de la technologie. Les composants sont au cœur des produits électroniques et constituent une part significative de la nomenclature d'un produit. Un écosystème dynamique de fabrication de composants électroniques est vital pour la croissance durable à long terme de la fabrication électronique en Inde et permettre au pays d'atteindre une balance des paiements positive.

1.5 Les principaux obstacles qui entravent les investissements pour la fabrication de composants électroniques et de semiconducteurs incluent les importations avec des droits de douane (BCD) « nuls », la plupart des composants électroniques et semiconducteurs étant couverts par l'accord sur les technologies de l'information (ATI-1) de l'OMC ; le coût élevé des capitaux pour mettre en place des capacités évolutives permettant d'être compétitif à l'échelle mondiale ; une infrastructure inadéquate ; l'absence de sources d'alimentation en eau et en électricité adaptées, fiables et de qualité à des prix compétitifs ; l'absence de chaîne d'approvisionnement ; les coûts logistiques élevés ; l'absence de technologie, etc.

1.6 Le Mécanisme modifié de Package incitatif spécial était conçu pour offrir des incitations financières permettant de compenser ces obstacles et les coûts initiaux élevés et d'attirer les investissements vers le secteur de la fabrication électronique. Ce mécanisme était ouvert aux candidatures jusqu'au 31 décembre 2018 pour les nouveaux projets et les projets d'agrandissement. Ce mécanisme a offert des subventions aux dépenses d'investissement pour la mise en place d'installations de fabrication électronique (20 % pour les unités dans les ZES et 25 % pour les unités hors ZES). M-SIPS a joué un rôle important dans la promotion de l'investissement dans la fabrication électronique en Inde.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

2. Mécanisme de Promotion de la fabrication de composants électroniques et semiconducteurs (SPECS)

2.1 Il est proposé d'offrir une incitation financière de 25 % des dépenses d'investissement pour la fabrication des biens figurant sur la liste en annexe, qui font partie de la chaîne logistique d'un produit électronique dans le cadre du Mécanisme de Promotion de la fabrication de composants électroniques et semiconducteurs (SPECS).

3. Objectif

3.1 Ce mécanisme permettra de compenser les obstacles à la fabrication domestique des composants et semiconducteurs afin de renforcer l'écosystème de fabrication électronique du pays.

4. Eligibilité

4.1 SPECS sera applicable aux investissements dans de nouvelles unités, ainsi qu'à l'augmentation de la capacité, la modernisation et la diversification d'unités existantes.

5. Seuils limites

5.1 Les seuils minimums d'investissement pour être éligible dans le cadre du mécanisme figurent en annexe.

5.2 Les seuils sont identiques pour les nouvelles unités ou l'augmentation de capacité, la modernisation et la diversification d'unités existantes.

5.3 Des examens périodiques seront menés pour faire évoluer, si nécessaire, la liste des biens ou les seuils pour lesquels des incitations sont offertes.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

6. Durée du mécanisme

6.1 SPECS sera initialement ouvert aux candidatures pour une période de 3 ans à compter de la date de notification. Les candidatures reçues dans le cadre du mécanisme seront évaluées au fur et à mesure et la mise en œuvre continuera en fonction des approbations accordées dans le cadre du mécanisme.

7. Incitations dans le cadre du Mécanisme

7.1 Une incitation de 25 % sur les dépenses d'investissement sera fournie aux unités effectuant des investissements pour les biens de la liste en annexe. L'incitation sera versée sous la forme d'un remboursement.

7.2 Les dépenses d'investissement correspondront à la somme des dépenses en usines, machines, équipements, outils et technologies connexes, notamment pour la recherche et le développement (R&D). Les détails des dépenses d'investissement éligibles seront inclus dans les Lignes directrices. La valeur totale de la rénovation de l'usine, des machines et des équipements (y compris les outils connexes et la R&D), importés ou sourcés domestiquement, n'excédant pas 20 % du total de l'usine, des machines et des équipements (y compris les outils et la R&D), sera prise en compte pour le calcul de cette incitation.

7.3 Les incitations offertes par le Gouvernement d'État ou l'une de ses agences ou organismes locaux, le cas échéant, compléteront les incitations éligibles dans le cadre du mécanisme proposé.

7.4 Les candidats seront également éligibles aux avantages d'autres mécanismes du gouvernement indien. Toutefois, les investissements des candidats dans le cadre du mécanisme M-SIPS pour lesquels des incitations ont été demandées ne seront pas considérés comme investissements éligibles dans le cadre du mécanisme SPECS.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

8. Processus d'approbation et de versement

8.1 La candidature au mécanisme peut être déposée par n'importe quelle entité enregistrée en Inde.

8.2 Chaque candidature sera traitée comme un nouvel investissement et une candidature séparée. La candidature devra uniquement concerner des projets mono-phase et les candidatures multi-phases ne seront pas examinées dans le cadre du Mécanisme. Les candidats peuvent cependant déposer plusieurs candidatures pour plusieurs emplacements.

8.3 Les candidatures initiales dûment complétées et envoyées avant la date de fin du mécanisme seront évaluées et approuvées au fur et à mesure.

8.4 Les incitations dans le cadre du mécanisme seront applicables à compter de la date de confirmation de réception de la candidature. La confirmation sera envoyée après un examen initial de la candidature. La confirmation de la candidature ne constitue pas une approbation dans le cadre de SPECS.

8.5 L'incitation sera disponible pour les investissements réalisés dans les 5 ans suivant la date de confirmation de la candidature.

8.6 L'incitation sera versée en contrepartie des dépenses d'investissement éligibles après l'approbation de la candidature, à condition que les dépenses d'investissement dépassent la valeur seuil et que la production commerciale ait commencé. Les demandes ultérieures relatives à l'incitation pourront être soumises une fois tous les six mois.

8.7 L'unité recevant l'incitation dans le cadre de SPECS devra conserver une production commerciale pour une période minimale de 3 (trois) ans à compter de la date de lancement de la production ou 1 (un) an à compter de la date de réception de la dernière incitation, la date la plus tardive étant retenue.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

9. Mécanisme de gouvernance

9.1 Le mécanisme sera mis en œuvre par le biais d'une agence centrale. L'agence centrale évaluera les mérites de la candidature.

9.2 Cette agence centrale jouera le rôle d'agence de gestion du projet (PMA) et sera responsable des services de secrétariat, de gestion et d'assistance à la mise en œuvre, et d'autres responsabilités assignées ponctuellement par le MeitY. Le fonctionnement et les responsabilités de la PMA seront définies dans les Lignes directrices du mécanisme publiées séparément par le MeitY.

9.3 Pour mener à bien les activités relatives à la mise en œuvre de SPECS, la PMA devra notamment :

9.3.1 Recevoir la candidature, envoyer les confirmations, effectuer les évaluations et vérifier l'éligibilité des candidats à l'assistance dans le cadre du Mécanisme.

9.3.2 Examiner les demandes de remboursement et verser l'incitation aux candidats approuvés.

9.3.3 Communiquer des rapports périodiques au MeitY relatifs à l'avancée et à la performance du Mécanisme.

9.4 Le PMA présentera les candidatures évaluées et déclarées éligibles devant un Comité exécutif (EC) constitué par le Ministère de l'électronique et des technologies de l'information (MeitY). L'EC sera présidé par un fonctionnaire du MeitY de grade minimum co-secrétaire. L'EC comprendra des représentants des ministères, départements et organisations concernés. L'établissement, le fonctionnement et les responsabilités de l'EC seront détaillés dans les lignes directrices du mécanisme.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

9.5 L'EC recommandera à la PMA l'approbation, le rejet ou la modification des candidatures. Sur la base des recommandations de l'EC, la PMA enverra la lettre d'approbation au candidat, en faisant parvenir une copie au MeitY.

9.6 Le MeitY allouera les provisions budgétaires pour le versement des incitations aux projets approuvés dans le cadre du mécanisme. Le versement des incitations sera effectué par la PMA sur la base des conditions d'approbation et de ses règles financières. La PMA devra envoyer ses besoins budgétaires au MeitY de manière régulière sur une base consolidée, et non projet par projet.

9.7 L'avancée du Mécanisme sera examinée par un Conseil de Gouvernance (GC) constitué par le MeitY sous la présidence du Secrétaire du MeitY. Le GC comprendra des experts du gouvernement et de l'industrie. Le GC examinera périodiquement l'avancée du mécanisme et des projets liés. Le GC aura le pouvoir d'apporter des modifications aux lignes directrices du mécanisme de manière ponctuelle pour la réussite de la mise en œuvre du Mécanisme. L'établissement, le fonctionnement et les responsabilités du GC seront détaillés dans les lignes directrices du Mécanisme.

9.8 La liste des biens éligibles à l'incitation dans le cadre du mécanisme, ainsi que les seuils applicables, seront examinés et mis à jour ponctuellement par le Conseil de Gouvernance.

9.9 Pour le fonctionnement efficace du mécanisme SPECS, des lignes directrices d'Évaluation et de Versement des incitations seront préparées et publiées séparément par le MeitY.

9.10 Une évaluation intermédiaire du mécanisme sera réalisée pour évaluer les bénéfices pour l'industrie et l'économie par rapport aux objectifs déclarés.

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

Liste des biens éligibles à l'incitation dans le cadre de SPECS

A. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 50 millions de roupies (INR 5 crore)

No S.	Description des biens
1.	Composants TMS, notamment puces LED
2.	Modules de puces pour cartes à puce, antennes et étiquettes RFID, CoB / SiP
3.	Composants passifs (résistances, capacités, ferrites, etc.) pour les applications électroniques
4.	Composants électrochimiques (transformateurs, inducteurs, bobines, relais, commutateurs, micromoteurs, moteurs pas-à-pas, moteurs sans balai, connecteurs, dissipateurs thermiques, antennes, haut-parleurs, microphones, etc.) pour les applications électroniques
5.	Magnétrons, guides d'ondes, circulateurs, raccords, isolateurs, filtres, aimants, composants RF pour les applications électroniques
6.	Circuits imprimés (PCB), circuits imprimés laminés, préimprégnés, films photopolymères, encres d'impression de circuits imprimés, électronique flexible imprimé
7.	Capteurs, transducteurs, actionneurs et cristaux pour les applications électroniques
8.	Modules de caméras, moteurs vibrants, sonneries
9.	Câbles USB / Données, Câbles HDMI
10.	Biens d'investissement pour tous les biens couverts par SPECS

B. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 150 millions de roupies (INR 15 crore)

No S.	Description des biens
1.	Composants actifs : a. Appareils semiconducteurs distincts (transistors, diodes, etc.)

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

	b. Semiconducteurs de puissance (FETs, MOSFETs, Thyristors, etc.)
2.	Préforme de silice et fibre optique
3.	Assemblage d'écrans, de panneaux tactiles et de verre de protection

C. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 250 millions de roupies (INR 25 crore)

No S.	Description des biens
1.	Composants micro/nano-électroniques, par exemple microsystemes électromécaniques (MEMS) et nanosystemes électromécaniques (NEMS)
2.	Unités d'assemblage, de test, de marquage et d'emballage (ATMP)

D. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 750 millions de roupies (INR 75 crore)

No S.	Description des biens
1.	Pièces mécaniques (plastique et métal) pour les applications électroniques

E. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 2,5 milliards de roupies (INR 250 crore)

No S.	Description des biens
1.	Semiconducteurs composés (GaN, SiC, GaAs, etc.) et appareils, circuits intégrés et composants optoélectroniques de photonique sur silicium

F. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 5 milliards de roupies (INR 500 crore)

W-18/30/2019-IPHW-MeitY
Ministère de l'électronique et des technologies de l'information
(Division IPHW)

No S.	Description des biens
1.	Gaufrettes de semiconducteurs

G. Liste des biens ayant un Seuil d'investissement minimum de 10 milliards de roupies (INR 1,000 crore)

No S.	Description des biens
1.	Circuits intégrés semiconducteurs (ICs) (logiques [microprocesseurs, microcontrôleurs, processeurs de signal numérique (DSP), circuits intégrés propres à une application (ASICs), etc.], mémoires, circuits pour signaux analogiques /mixtes, etc.)
2.	Unités de fabrication d'écrans (écrans à cristaux liquides (LCD), écrans à diodes électroluminescentes (LED), écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour les applications électroniques)
